



KONICA MINOLTA

半導体製造装置向け 光学コンポーネント事業説明会

コニカミノルタ株式会社

執行役員 光学コンポーネント事業部長 野村 由之

2026年3月18日



上流・光コントロール領域へ 価値提供を通じて、バリューチェーン全体の進化を支援

FY21~22
環境認識・意思決定
半導体検査装置向け
光学コンポーネントを
注力領域に選定

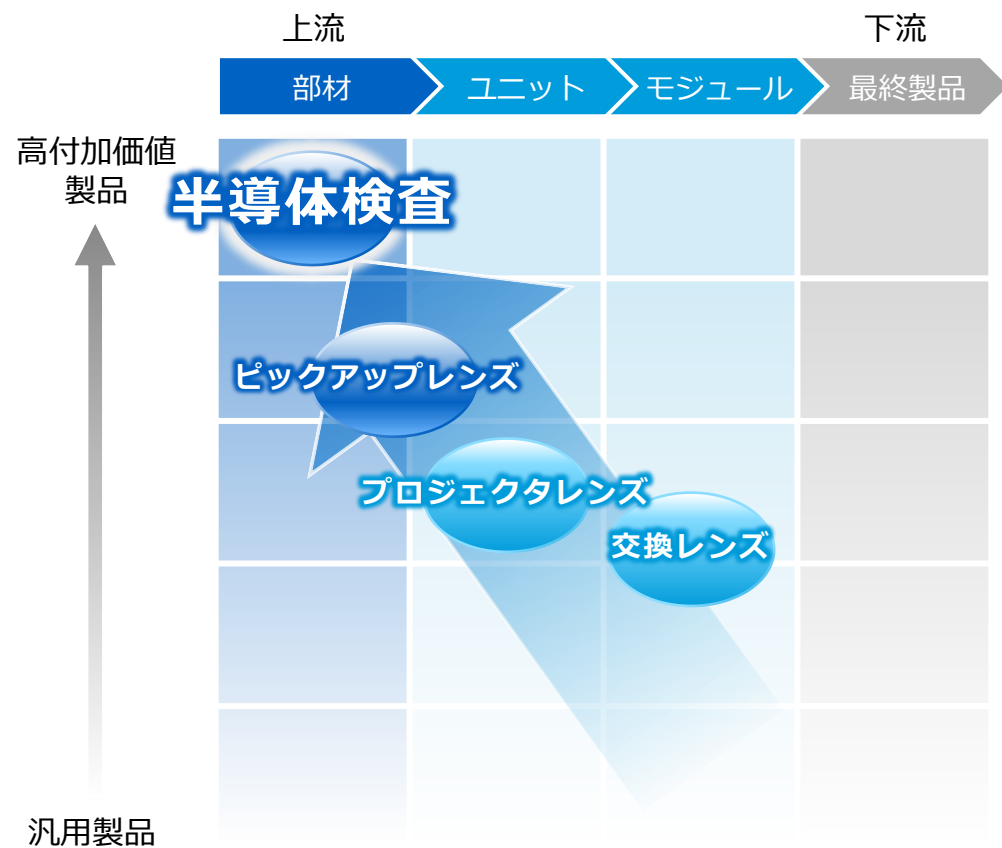
FY22~25
半導体領域へ注力する体制構築
設備投資・技術獲得

FY25~
事業拡大

事業内ポートフォリオ転換による収益性改善

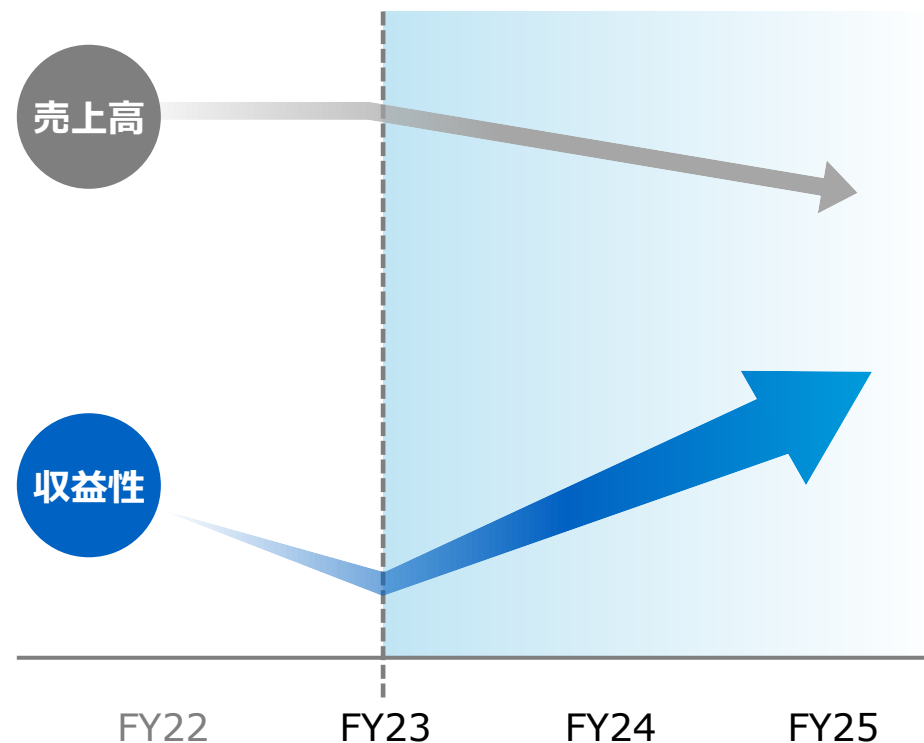
- 半導体検査装置向けに注力
- 非産業用途の一部持分譲渡

製品構成



*プロジェクタ用レンズ、交換レンズなど

売上高・収益性推移イメージ



1900年代～



カメラ

1980年代～



カメラ用
交換レンズ

1990年代～



光ディスク用
ピックアップレンズ

2010年代～



半導体検査装置向け
光学コンポーネント

事業を支えてきた光学技術

球面レンズ高精度加工



- $\lambda/40$ レベルの高精度研磨
- 光軸のブレを抑える
芯取り加工

薄膜コーティング



- 光学製品の性能を向上
させる薄膜コーティング

ハイエンド光学設計



- 高難度仕様に応える設計力
- 評価結果との照合により
求められる性能を実現

評価・位置合わせ



- 自社開発の評価装置で
設計と評価を連動させた
高精度な位置合わせ

半導体検査装置向け 光学コンポーネント事業

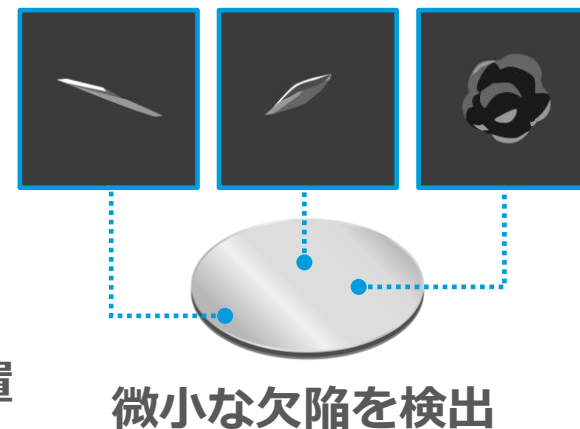
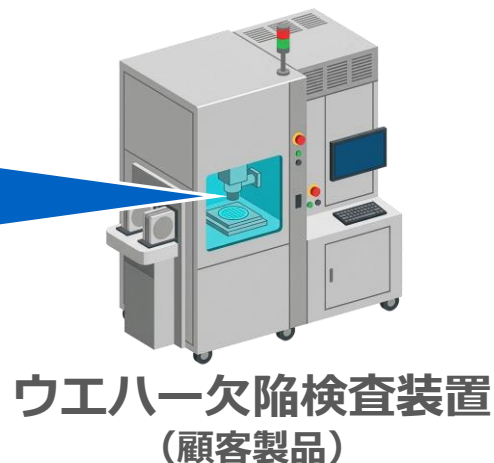
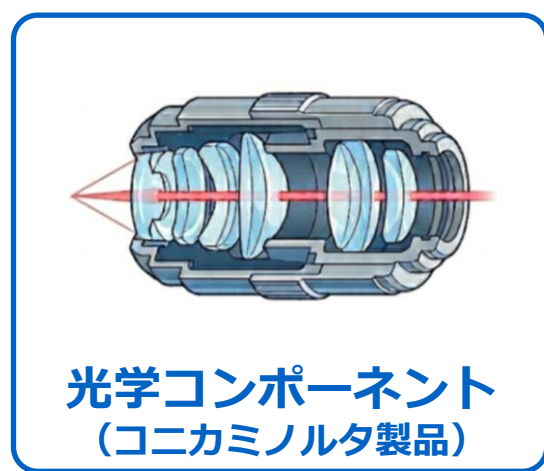


KONICA MINOLTA

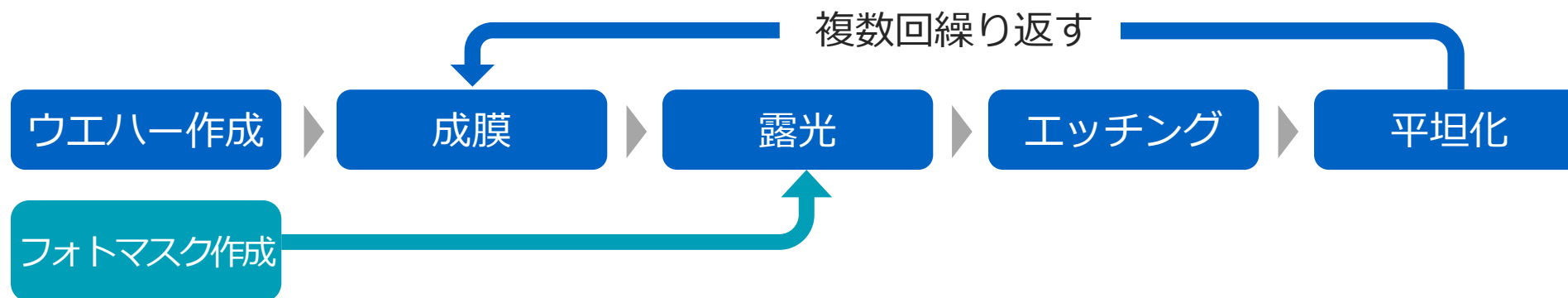


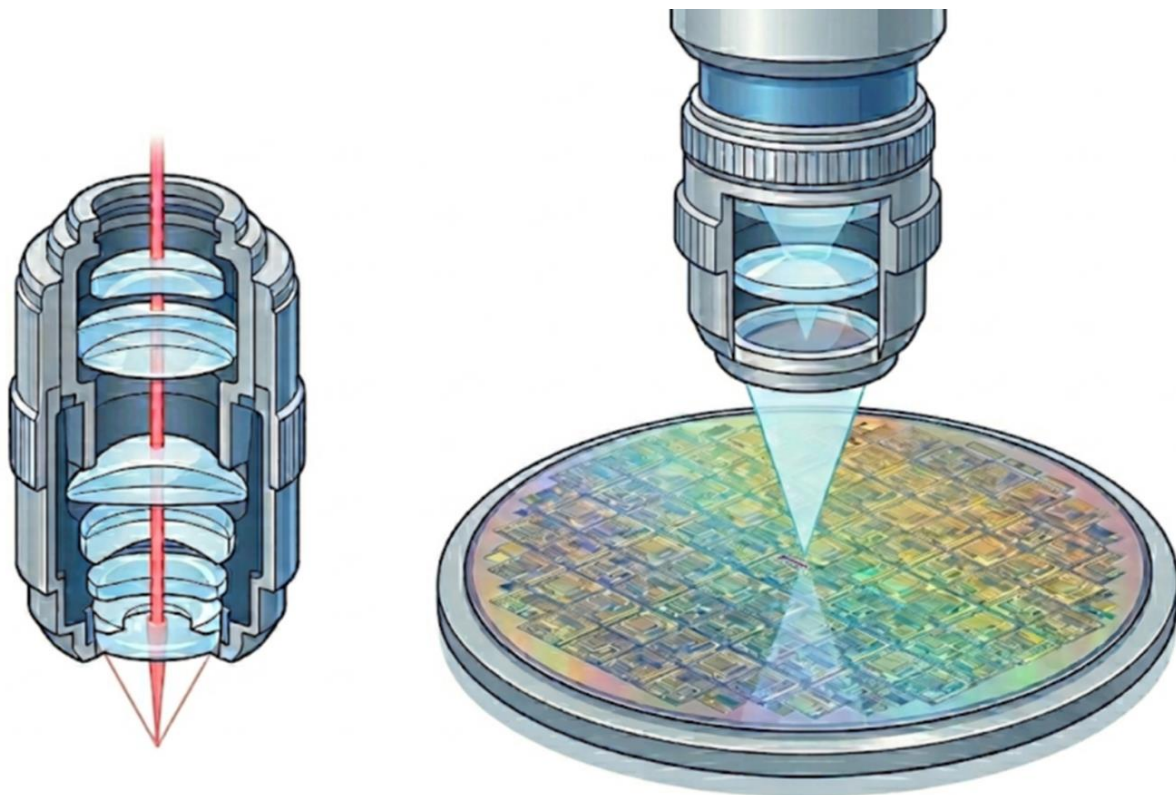
前工程

パートナーとの連携で検査工程を支える



後工程



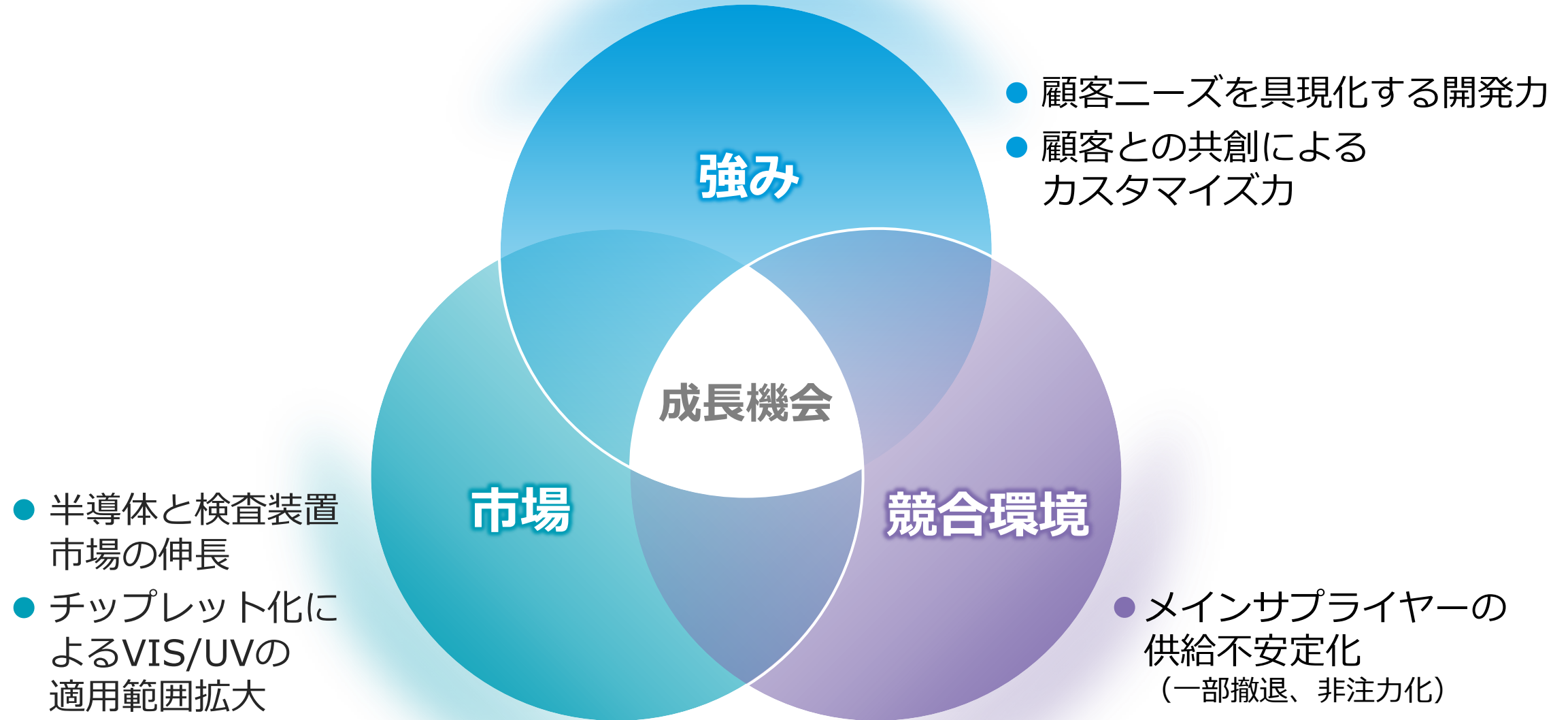


求められる性能

- 高分解能、高NA
- 低収差
- 高透過率

コア技術

- 光学設計・シミュレーション技術
- 高精度レンズ加工技術
- 低反射コーティング技術
- 精密組立・位置調整技術
- 高精度評価技術



強固な連携を通じて真のパートナーに



有力メーカー
との
強固な連携

検査装置
メーカー



FY22

顧客要望を捉えた製品を提供し
信頼関係を構築



FY25現在

顧客と共創する
戦略的パートナーに

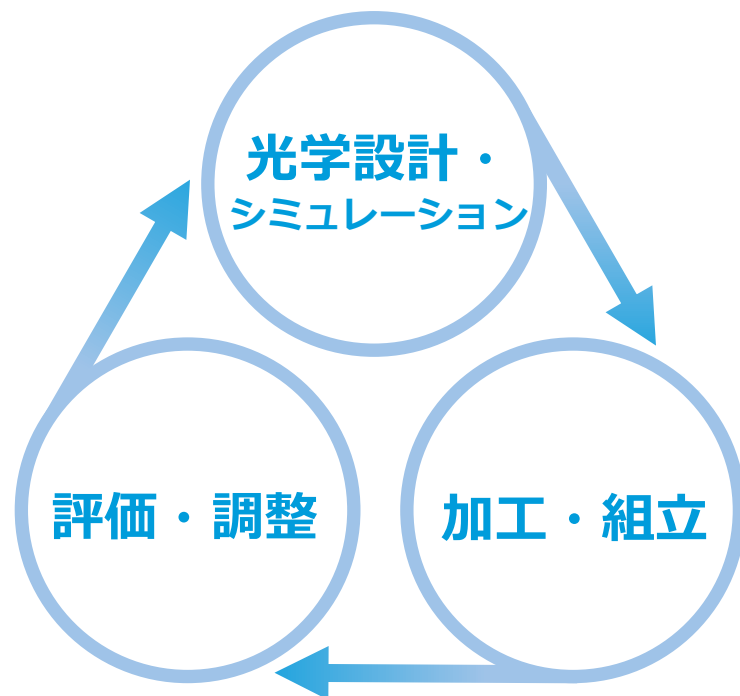


目指す姿

さらなる価値提供により
顧客の製品を支える
真のパートナーを目指す

顧客の困りごとを解決する製品・サービスを提供
顧客の戦略的パートナーに

顧客ニーズを具現化する開発力



顧客との共創によるカスタマイズ力

開発：顧客の業務プロセスと一体化

生産：開発から試作・量産まで
一気通貫の体制

マーケ・営業：顧客firstでの提案

サービス：ロードマップ達成をサポート
する共同開発関係

市場構造：光学コンポーネントは半導体業界を支えるキーパーツ



半導体

AI需要増加

チップレット化

半導体検査装置

チップレット化に伴う工程の多様化

検査装置向け光学コンポーネント

需要伸長に対応する供給力

カスタマイズ力

SAM
約2,000億円
(当社推定)

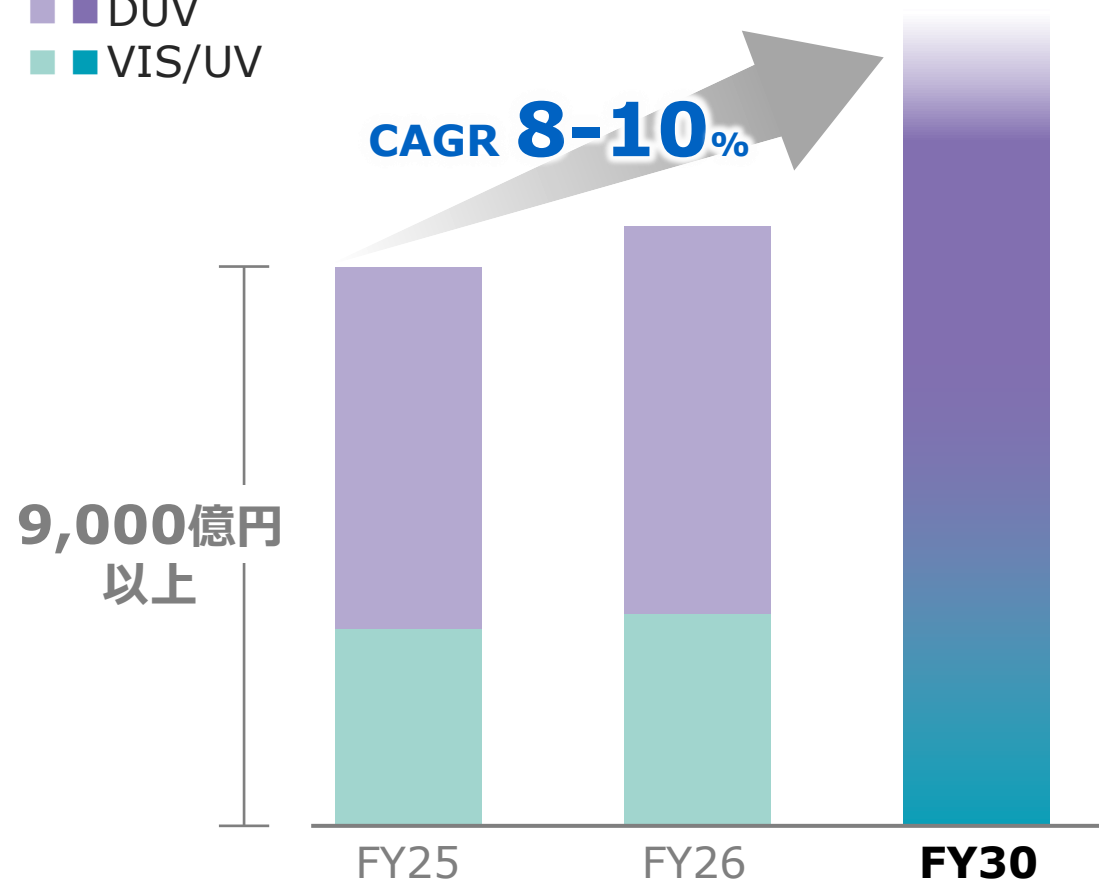
市場規模：ウェハ欠陥検査装置の伸長に伴う拡大



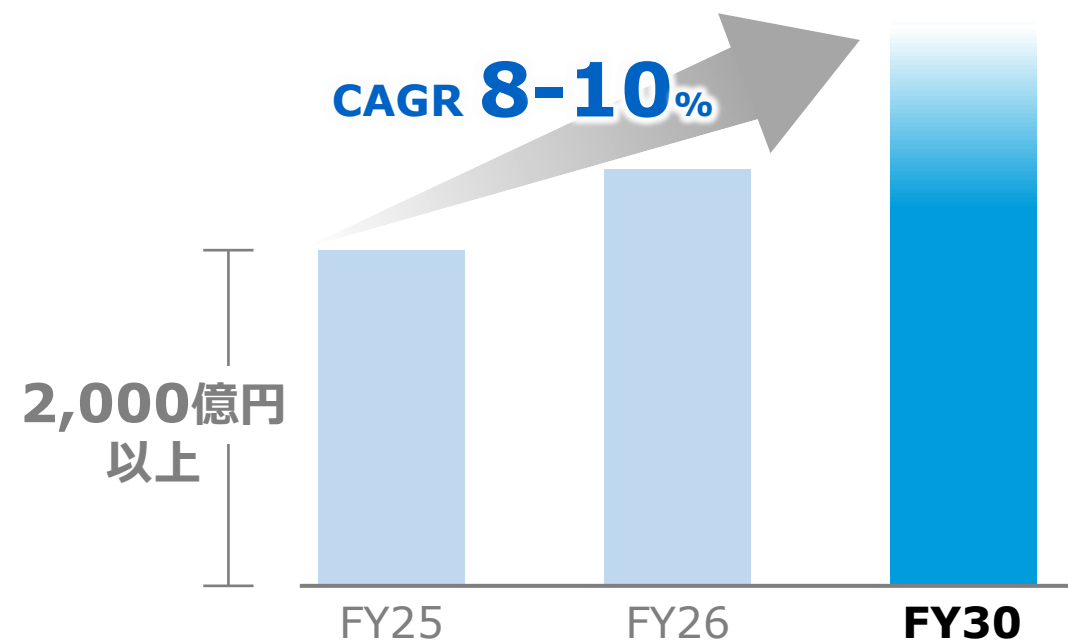
AI向け半導体などの需要増により高い成長率を見込む

ウェハ欠陥検査装置

■ DUV
■ VIS/UV



検査装置向け光学コンポーネント



*当社推定

ターゲットとなる波長領域



Step1

VIS/UV領域

高輝度プロジェクター用レンズ
などで培った
コニカミノルタの得意領域

波長領域

EUV	DUV	UV	VIS	NIR/IR
13.5nm	193nm	350nm	450nm	1000nm
0.1nm	2nm	4nm	5nm	10nm

面精度

Step2

DUV領域

技術獲得と事業拡大を目指す領域

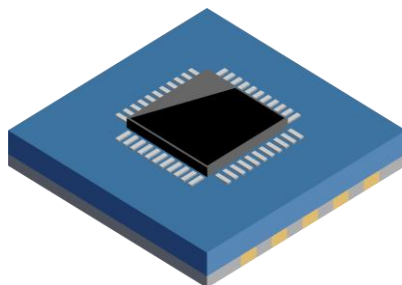
半導体の新たな製造方式による光学コンポーネントのニーズ変化



～AI向けなどのロジック半導体を中心に～

前工程

モノリシック半導体

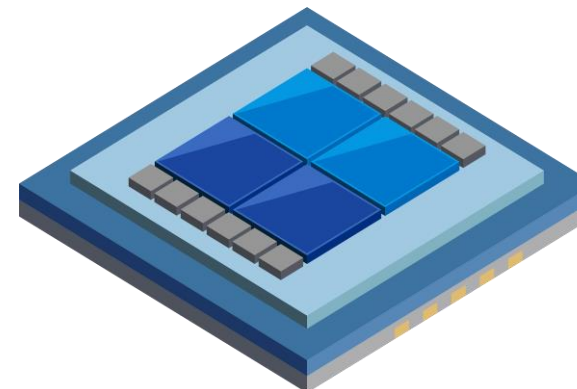


- 一つのウエハーに異なる回路を集積
- 微細化により高性能化を追求

ロジック半導体ではDUVを用いた
検査が必要

後工程（先端パッケージ）

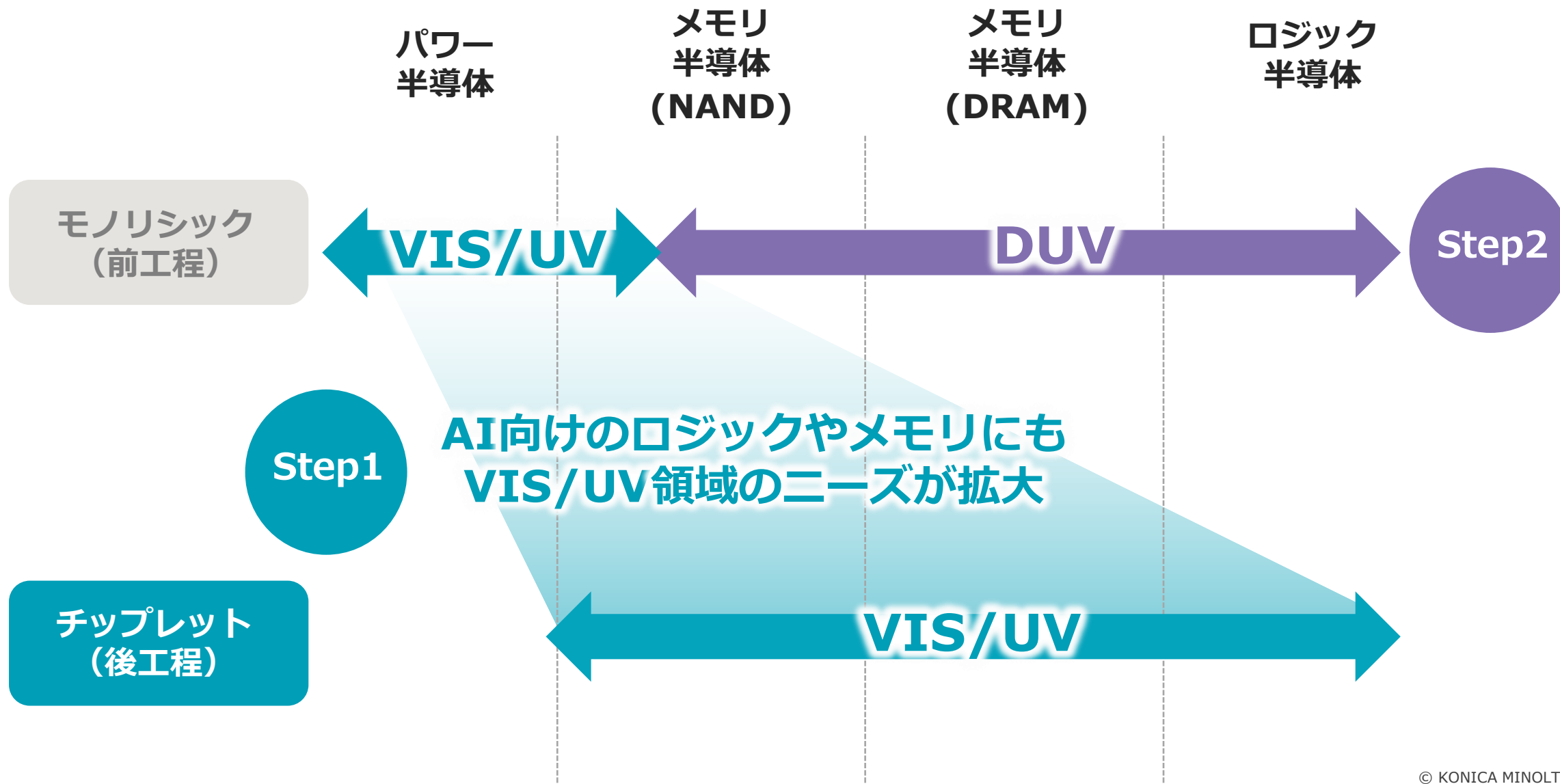
チップレット実装



- 精度が異なるチップを接続して高性能化を実現
- 一部チップはモノリシック半導体ほどの精度は不要
- 検査項目の多様化

ロジック半導体でもVIS/UVを用いた
検査ニーズが拡大

ロジック・メモリ半導体（含むAI）の検査装置向けに拡大



競合の撤退・非注力化によりコニカミノルタへの期待が一層高まる

VIS/UV 領域

A社


一部撤退

他用途のレンズ製造へ注力

B社


非注力化

他用途のレンズ製造へ注力

C社


増強の可能性
は限定的

VIS/UV領域のレンズは
生産キャパシティは限定的

など



新規参入
難易度：高

DUV領域

VIS/UV領域と同様に、他用途のレンズ製造への注力
などによりメインサプライヤーの供給不安定さが懸念される

今後の戦略



Step1

VIS/UV領域のシェア拡大

- 半導体需要増加
- チップレット化でAI向けなどのロジック・メモリ半導体まで対象が広がる
- 競合の撤退・非注力化で安定供給需要増

Step2

中長期：DUV領域への拡大

- 半導体需要増加
(特にDUVは大きく伸長)
- 競合の撤退・非注力化で安定供給需要増

生産能力拡大

生産効率向上

コニカミノルタ
の戦略

次世代加工機の導入

ケミカルコンタミ対応

戦略的パートナーとともに成長へ

生産体制強化

大阪狭山サイトの生産体制強化

生産ラインを増強



東京サイト八王子に 第2拠点の新設

FY25 3月末に本格稼働予定



生産効率向上

技能に依存した加工から

DX活用による標準化

(NC加工機の導入)

- 熟練者の技能を定量化して標準化に活用
- 工程データ可視化により品質向上を実現



FY26

生産能力増強 **2.6倍**

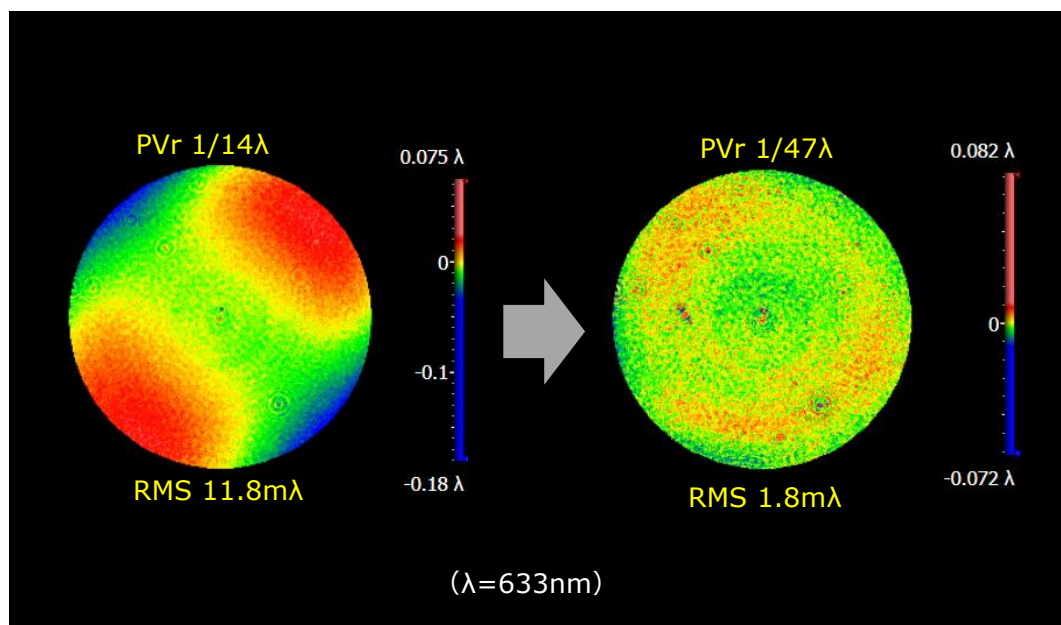
(FY24対比)

～戦略的パートナーとの協力体制によるDUV領域強化～

FY25までに導入済

次世代加工機：
イオンビーム研磨（IBF）

DUV領域に応用可能な高精度研磨を実現



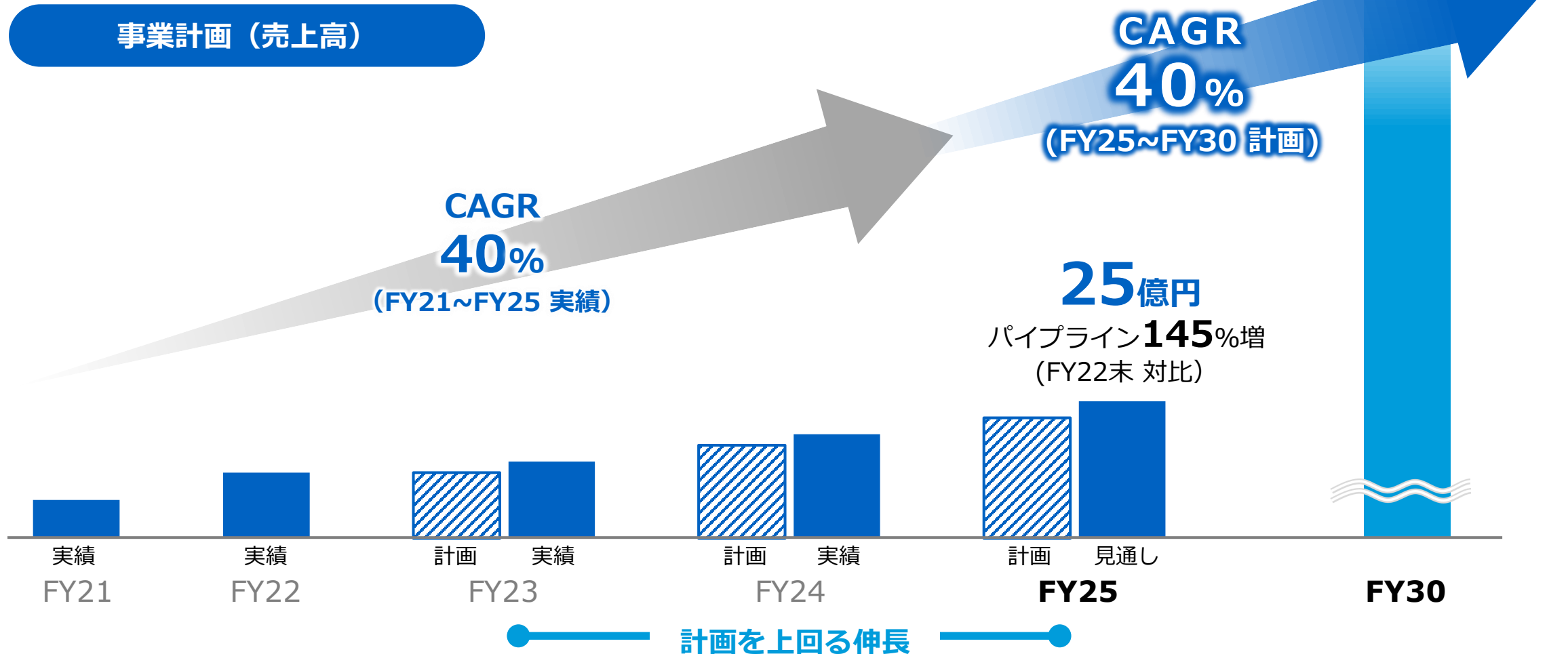
今後の取り組み

ケミカルコンタミ対応：
クリーン技術強化クリーン環境の管理技術、特殊洗浄、
材料選定、梱包など

半導体検査装置用光学コンポーネント拡大計画

- VIS/UV領域が好調、計画を1年前倒し
- 今後はDUV領域にも拡大し、有力メーカーのインハウストップを目指す

事業計画（売上高）





KONICA MINOLTA

- 本資料の記載情報

本資料におきましては、四捨五入による億円単位で表示しております。

- 将来予想に係わる記述についての注意事項

本資料で記載されている業績予想及び将来予想は、現時点における事業環境に基づき当社が判断した予想であり、今後の事業環境により実際の業績が異なる場合があることをご承知おき下さい。